

证券代码：688173

证券简称：希荻微

记录编号：2026-IR-003

## 希荻微电子集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	【平安证券股份有限公司】：杨兆基 【平安证券股份有限公司】：夏磊 【平安证券股份有限公司】：何颖妍 【深圳纽富斯投资管理有限公司】：廖颖聪 【深圳市梦工场投资管理有限公司】：周青 【广州鸣瑜私募证券投资基金管理有限公司】：刘康 【天时私募证券投资管理（广州）有限公司】：冯恺 【广州守正用奇私募基金管理有限公司】：李昱君 【广东阿米巴基金管理有限公司】：廖杉杉 【恒丰银行股份有限公司】：黄丹霞
时间	2026年4月24日
地点	公司会议室
上市公司接待人	【主讲人】：

<p>员姓名</p>	<p>卢海航 董事、董事会秘书、财务负责人 吴昊晟 投关经理</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>第一部分 公司介绍</b></p> <p>2025 年，公司实现营业总收入 93,943.50 万元，较上年同期上升 72.21%；实现毛利润 28,284.37 万元，较上年同期上升 66.71 %；实现归属于母公司所有者的净亏损 11,391.86 万元，亏损金额较上年同期减少 17,667.88 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损 11,871.97 万元，亏损金额较上年同期减少 18,148.51 万元。截至 2025 年末，公司总资产为 185,196.63 万元，较上年度末上升 2.30%，资产负债率为 19.67%，资本结构稳健，财务安全性高。同时，公司应收账款与存货的周转速度加快，运营效率继续提升，存货金额处于合理区间。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有员工 342 人，其中研发人员 210 人，占员工总数的 61.40%；硕士及以上学历的研发人员 80 人，占研发人员总数的 38.10%；公司累计获得授权发明专利 253 项，集成电路布图设计专有权 14 项。</p> <p><b>第二部分 问答环节</b></p> <p>Q: 请问公司为何境外业务占比及增速较大？</p> <p>A: 2025 年，公司销售收入以境外销售为主，占比 83.08%；境外的销售收入主要来自经销商设立在中国香港地区的交易主体，符合行业惯例。境外销售收入较上年大幅上升 85.92%，主要系公司在境外开展的音圈马达驱动芯片以及传感器芯片及其解决方案业务销售收入大幅增长所致。</p> <p>Q: 请问公司库存情况如何，公司是先有产品再有订单，还是先有订单再有产品？</p> <p>A: 截至 2025 年末，公司存货净额为 2.65 亿元，占总资产</p>

比重为 14%；2025 年，公司存货周转天数为 111 天。鉴于公司采用 Fabless 模式，即晶圆制造与封装测试环节委外，供应链的响应周期通常在 3-5 个月，库存水位与周转效率符合业务发展逻辑，处于健康合理区间。在商业模式上，公司坚持“双轨并行”策略：一方面稳固消费电子基本盘；另一方面积极拓展汽车电子及计算与存储等前沿领域。公司生产模式依据客户需求灵活配置，既包含面向核心大客户的产品研发与备货，也涵盖基于市场预判的产品研发与备货。

Q：请问公司在模拟芯片领域的行业地位如何？

A：公司深耕模拟芯片领域多年，目前已形成“电源管理+端口保护+视觉感知+触控传感”的全链条业务布局，在细分赛道确立了显著的行业领先地位：（1）在电源管理及端口保护领域，公司成功卡位高端消费电子供应链，是安卓链手机品牌客户的核心供应商之一；（2）在音圈马达驱动芯片领域，公司凭借技术与规模优势，稳居细分市场头部供应商地位；（3）在传感器芯片领域，公司通过控股子公司 Zinitix 深度绑定全球消费电子巨头。公司控股子公司 Zinitix 是三星电子的一级供应商，主要为其提供 Touch 触控芯片与模组以及 Haptic 触觉反馈驱动芯片。此外，公司亦较早布局汽车电子和云计算领域，产品应用日趋高端。

Q：请问公司 2025 年经营活动现金流量净额为负的原因，公司目前账上资金是否充裕？

A：2025 年度，公司经营活动现金流量净额为-1.66 亿元，相较上年同期缺口有所收窄。该指标为负，主要系公司作为技术驱动型 Fabless 企业，持续保持高强度研发投入所致。2025 年，公司经营活动产生的现金流入，尚不足以覆

盖包括产品备货、职工薪酬及各项税费在内的刚性运营支出。尽管经营性现金流阶段性承压，公司整体现金储备充裕，财务结构稳健。截至 2025 年末，公司货币资金账面余额达 7.67 亿元，资产负债率维持在 19.67% 的低位。

Q: 请问公司上市以来是否做过再融资，筹资活动现金流入主要是借款吗？

A: 上市以来，公司筹资活动现金流入主要系公司银行借款及员工行权收到的现金。

Q: 请问公司总部大楼建设造价如何，使用的是自有资金还是外部借款，预计何时可以入驻，会对公司日常经营产生哪些影响？

A: 公司总部大楼系 IPO 募投项目的重要组成部分，项目总投资预算逾 2 亿元，资金来源为公司的募集资金。工程进度方面，总部大楼已于 2025 年 9 月顺利完成封顶，预计将于 2026 年第四季度正式投入使用。该项目对公司长远发展的战略意义主要体现在：其一，夯实品牌势能，地标性总部将显著提升企业形象与行业地位；其二，构筑人才高地，优化办公环境与配套，增强对高端芯片人才的吸引力及团队凝聚力；其三，发挥产业集聚效应，依托物理空间优势深化与产业链上下游的协同合作；其四，培育第二增长曲线，通过部分区域的市场化租赁，为公司带来一定的租金收益，反哺主营业务。

Q: 请问公司原实际控制人股份继承过户尚未完成的原因，是否存在争议及会对公司经营产生影响？

A: 公司原实际控制人之一戴祖渝女士于 2025 年 5 月逝世，其生前直接持有公司股份 93,790,457 股。2025 年 8 月

25日，经广东省深圳市先行公证处公证，上述股份全部由其长子暨公司实际控制人之一 TAO HAI（陶海）先生继承，该继承事项权属清晰，不存在任何权属争议或潜在纠纷。鉴于股份继承过户登记手续所需的相关文件及所涉及的费用仍在准备和筹措过程中，办理周期和程序比预期较长和繁杂，上述股份继承过户尚未办理完成。公司将持续关注相关事项进展情况，并及时履行信息披露义务。上述事宜不会影响公司经营稳定性，不会对公司日常生产经营活动和财务状况产生重大影响。

Q：请问公司业务增长的逻辑主要是国产替代吗？

A：在半导体自主可控的背景下，公司凭借在高端消费电子、汽车电子等领域的产品突破，持续受益于国产供应链份额的提升。此外，依托 Fabless 模式的灵活性，公司深度绑定行业头部客户，通过定制化开发共同拓展新兴增量市场，实现从“替代者”向“定义者”的角色延伸。

Q：请问公司是否已经完成诚芯微收购项目？预计对公司财务报表产生哪些影响？

A：诚芯微已按照《股份转让协议》约定于 2026 年 3 月 20 日（以下简称“交割日”）办理完成股东变更、章程修改、董事变更等与本次交易相关的工商变更登记和备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。自交割日起，诚芯微成为公司的全资子公司。交易对方同意对业绩承诺期内（即 2025 年度、2026 年度、2027 年度）标的公司实现的业绩进行承诺，具体为：标的公司于业绩承诺期实现的净利润分别不低于 2,200 万元、2,500 万元和 2,800 万元，三年累积实现的净利润不低于 7,500 万元。

	<p>Q: 公司最新的口号是“AI 铸芯和芯驱 AI”，能结合公司业务详细解释下其含义吗？</p> <p>A: 公司属于芯片设计行业，已在芯片的研发设计环节引入 AI 工具以提高效率，缩短芯片研发及验证周期。另外，公司也在积极布局 AI 端侧（包括 AI 手机和 AI 眼镜等）和 AI 算力（主要给 AI 算力提供电源管理芯片产品及系统级解决方案），致力于成为连接虚拟智能与现实世界的半导体桥梁，期待与 AI 浪潮同频共振。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 4 月 24 日